(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—91991

⑤Int. Cl.³
B 23 K 20/06

識別記号

庁内整理番号 7516-4E ❸公開 •昭和56年(1981) 7月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

匈アルミニウム管棒と異種金属管棒の接合方法

願 昭54-169908

②出 願 昭54(1979)12月26日

⑫発 明 者 秋月東士郎

横浜市戸塚区矢部町756

⑪出 願 人 秋月東士郎

横浜市戸塚区矢部町756

個代 理 人 弁理士 小野寺悌二

明 細 看

1.発明の名称

②特

アルミニウム管権と異種金属管権の接合方法 2. 特許讃求の範囲

8. 発明の詳細な説明

本発明はアルミニウム質構取はアルミニウム合金管経(以下アルミニウム管と云う)と鰯、

鋼、黄銅などの共種金属管様の重ね継ぎ(突き合せも含む)による接合方法に関するものである。尚「管標」とは管或は爆の意味である。

薄肉のアルミニウム管権と異種金属管程との接合に際し、溶解融溶接やその他の溶接では接合部の接合境界面に傾くて脆い厚い金属間化合物が生成されて機械的弱点があり実施し難い。

これらの弱点を解決する方法としては強強という。これはアルミニウム管機と共和金属管機の度和機等の接合の接触における加工コイル内において誘導加入を発生させた後、加工コイルに大電流のパルル総を発生させた後、加工コイルに大電流のがルル総を与えて接合部に電磁気の勝ちかの接合を関係を134344 号公報のを国際では、134344 号公報の接合を得よっとして所要強度の接合を得よっとしてが必要にある。

然しながらこの方法によるときはニッケル合 金の皮機層を介在させない場合の接合よりも過 かに良い結果が得られるが、尚使用目的に応じ、た所要強度が得られない遅れがあるばかりかれない。な台条件が不安定で歩りの思い欠点をニックル投資を立ったは固めていまニウム酸化物を全を生成化のとなりアルミニウム酸化物の選元が完全に行なわれないことに基因する。

本発明は明述の電磁圧接装置による汎用接合法を改良したもので、更に移合強度を高めると共に接台条件を安定させて歩留りを良くしようとするものである。

本発明者は神々研究を盲ねた結果でルミニウム管理部の接合値に供給、ニッケル、鯯と亜鉛合金によりませば、大き、シャンの単独取は生鉛とニッケル、鯯と亜鉛合金により金属皮膜を形成すると共に異独金属管準側の接合値にニッケル電気メッキ皮膜を施して互部にの接合値を突き合せ取は嵌合し、この接合部にの短圧接接値により誘導加熱、電磁的加圧力を

皮である。

### 実施例 2

篏合接台面 1 a に 亜鉛とニッケルの 合金以膜例

育化型約10%、肉化ニッケル10%、 ロッシェル約1%、 苛性ソーダ50% 溶液 に約40℃ 撹拌下で約90 秒処理し沈澄さ せた後水洗吃燥。

#### 寒施例 8.

嵌合接合面 la にニッケル皮膜例

### 実施例 4.

嵌合接合面 1 = に知皮膜例

城的> 1508/8 裕形 に アンモニア 水を機 整色を呈する 迄加え、 更に 歯 齢 加 単 解液を 無色を呈する 迄加えた 熱 裕 液 に 30 ~ 60 秒 施すことにより、より強制な接合強度を得ると 共に接合条件も安定し不良品の発生が殆んどな くすることに成功した。

本语明を更に詳記に説明するとアルミニウム管1と、銅、銅、黄銅などの共殖金属管2との各端部を雌雄の嵌合接合面1aには中鉛、ニッケル、銅、黄銅の単独取は亜鉛とニッケル、銅、黄銅の母金による金属及膜3を形成せしかるのであるが、先ずアルミニウム管1の嵌合を面1aを前性ソーダ溶液(45 g/l)で30~60秒常温処理した後水洗して前処理を施こし、これに以下の実施例の如く金属皮膜3を形成する実施例1.

## 嵌合接合面 1 \* に亜鉛皮膜例

酸化売鉛 100 8/ℓ、塩化アルミ 50 8/ℓ 苛性ソーダ 5 2 5 8/ℓの常温溶液に 30~60 砂浸漬し沈着させた後、水洗、乾燥させる。 亜鉛皮膜の厚さは 0.016 ~ 0.048 mg/cfl 程

浸漬し沈滑させた後、水洗後で燥。 実施倒 5.

# . 嵌合接合面 1a 化黄鳎皮膜例

青化第一銅11g、筒化亜約7g、1r化カリ13g、硫酸ソーダ25g、亜硫酸ソーダ8.5g、を水1 & に裕解させた熱格液に30~60 秒受債し沈着させた後、水洗乾燥。

他方銅、黄蚓、鋼等の典種金属管 2 の嵌合接合面 2 m にはニッケルを電気メッキにより皮膜してニッケル電気メッキ皮膜 4 を形成する。このニッケル電気メッキ皮膜 4 の厚さは 5 ~ 7 化程度である。

かようにして金属皮膜3或はニッケル電気メッキ皮膜4を形成した互いの嵌合接合面1。、2。を嵌合して接合部5となし、この接合部5を別途電磁圧接接置6の加工コイル7内に挿入配機し、この加工コイル7内において高周波電流(例えば8.1KH2)によって上記嵌合接合面1。、2。を溶験点以下に誘導加熱した後イグナイトロン8を動作させ直流電源9よりコンデンサー10に

### 特開昭56- 91991(3)

充電されたエネルギーを散加工コイル 7 に瞬時に送ることにより加工コイル 7 に衝線大電流を発生させ、この電流により発生する破界により加工コイル 7 内に挿入された形合部 5 は単磁的加圧力を供て接合される。

この本発明法の接合によって得た接合境界面の台金属(金属間化合物 )は、アルミニウム質と共獲金属質の直接接合の場合と比較し極めて減くて強固であり接合強度も強固で接合条件も安定している。

又典権金属管にニッケルメッキ皮膜を形成させない場合にアルミニウム管側に本発明と同様の金属皮膜3を形成して解磁圧接装置6により接合しても本発明による接合と比較して良好なる接合は得られない。このことは高周波加熱中の飼管又は黄銅管(異性金額管)側の嵌合接合面の酸化に基固する接合不完全によるものである。

又飼管、黄銅管等の異複分属管の嵌合接合面 にニッケル電気メッキ皮膜を配し、アルミニウ

部を電磁圧接接置の加工コイル内に配置して誘 導加熱した後接台部に大電流のパルスを与えて 軍磁的加圧力により接合するもので、その結果 アルミニウム管経と異植金属管松の直接接台、 或はアルミニウム智能と異概金属管機の何れか 一方にのみ削者には金属皮膜処理を、後者には ニッケル軍気メッキ災腹処理を施した接合と比 戦して極めて接合強度が強く、而も安定した接 合が得られた。このことは本発明法の場合アル ミニウム管軽の接合面と異種金属管機の接合面 上に施こしたニッケル電気メッキ皮膜との間に アルミニウムより酸化し鮮い安定した亜鉛、鰯、 結晶構造の異なるニッケルの単独或はこれらの **台金による金属皮膜が介在し、その結果生成さ** れるアルミニウム、ニッケルの合金編の組織、 組成に固溶範囲の広い安定した合金層が得られ て脆弱な金属間化合物の生成が抑制されたもの と考えられる。

### 战験結果

本発明法の実施例として実施したアルミニ

ム管の嵌合接合面を無処理或は研磨処理して接合しても特開的 5 1-1 3 4 3 4 4 号発明のニッケル合金の皮膜層を介在させる接合と同様本始明 法による接合と比較して使用目的に応じた所要 強度を得られない襲れがあるのみならず、接合 条件も不安定である。

尚異種金属管として鰯、黄銅について述べて 来たが鰯管についても強度の優れた接合が得られる。

又質のみならずアルミニウム様と典種金属株との尖き合せ接合でも優れた接合が得られる。 又尖き合せ接合でも良い。

本発明は叙上のようにアルミニウム智碑と編、黄銅等の異権金属管標の各端部を互いに突き合せ或は雌雄の篏合接合面とし、アルミニウム管標の接合面に亜鉛、ニッケル、網と亜鉛の合金により金属皮膜を形成すると共に、異種金属管標の设合面にはニッケル電気メッキ皮膜を施し、これら互いの接合面を突き合せ或は嵌合した接合

ウム管と銅管或は黄銅管の接合部の強度試験 は嵌合接合部を平板間にはさみ属平に抑しつ ぶした後試料内部に 10kg/cd の空圧を加え水 中に嵌合接合部を挿入して気泡の発生の有無 を調べ扁平気密試験により接合部の強度試験 を行なった。

#### 尚扁平塞るは

(扁平前の外径一扁平後の外径)ナ

(扁平前の外径)×100

で扱わしたものである。

A ℓ 8.0 × 1.0 <sup>1</sup> 端部フレア加工

Cu 又は黄銅管 8.0 × 0.5

又試験結果中 1) ~ 10 )までは本発明実施品である。

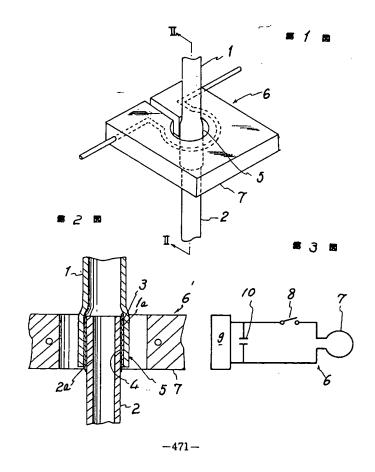
	Aℓ側の表面処理	Cu 側の表面処理	黄銅側の表面処理	扁平気密試験結果	開平気密試験 20 % を合格基準とした 場合の不良率
1)	亜鉛 沈 着	Ni 電気メッキ		> 40 %	< 3 %
2)	<b>亜鉛沈岩</b>		Ni電気メッキ	> 40%	< 3 %
3)	亜鉛+Ni 沈鷺	Ni 電気メッキ		> 40 %	< 3 %
4)	Ni 沈潛	NI 電気メッキ		> 40 %	< 3 %
5)	亜鉛+ Ni 沈着		Ni電気メッキ	> 40 %	< 3 %
6)	Ni 沈着		Ni 電気メッキ	> 40 %	< 3 %
7)	Cu 沈着	Ni電気メッキ		> 40 %	< 3 %
8)	Cu 沈滑		Ni電気メッキ	> 40 %	< 3 %
9)	黄銅(Cu+Zn)沈知	Ni 電気メッキ		> 40 %	<3 %
10)	黄銅(Cu+Zn)次層	Ni 電気メッキ	Ni 窜気メッキ	> 40 %	< 3 %
11)	なし			< 10 %	100 %
12)	r L	無電解Niメッキ		< 10%	100%
13)	tu L		なし	< 10 %	100%

	Aℓ 側の表面処理	Cu側の表面処理	黄銅伽の表面処理	扁平気密試験結果	扇半気密試験 20% を合格基準とした 場合の不良溶
14)	なし		無電解 Niメッキ (Ni沈着)	<10 %	. 100%
15)	α L	Ni 電気メッキ		10~ <50%	15 ~ 20 %
16)	te L		Ni 摩気メッキ	10~ <50%	15 ~ 25 %
17)	Zu 沈着	無電解 Ni メッキ		<10 %	100 %
18)	Zu 沈着	74 L	·	<10 ≴	100 %
19)	Ni 沈潜	無電解Niメッキ		<10 %	100%
20)	Ni沈滑	なし		<10 %	100%
21)	Zn + Ni 沈滑	無電解Niメッキ		<10 %	100 ≴
22)	Zn + Ni 沈着	な し		<10 %	100 \$
23)	Cu 沈潛	無電解Niメッキ		<10 %	100 ≴
24)	Cu 沈着	r L		< 10 %	100%
25)	黄銅(Cu+Zn)沈着	無砂鮮Niメッキ	, , , , , , , , ,	<10 %	100 ≴

# 4. 図面の開単な説明

第1図は本発明法の実施説明図、第2図は第 1図『一『線断面払大説明図であり、第3図は 本発明法に使用する電磁圧接接置の回路図であ る。

- 1 はアルミニウム質
- 2 は具積金属資
- 2 a は接合面
- 3 社金屬皮膜
- 4 はニッケル電気メッキ皮膜
- 5 は接合部
- 6 は電磁圧接装置
- 7は加工コイル



11/13/04, EAST Version: 2.0.1.4